

世界最高の生産性を実現する枚葉式ウエハー洗浄装置を発売

大日本スクリーン製造株式会社はこのほど、毎時800枚という高速洗浄能力と高い安定性を持つプロセス性能の両立により、世界最高^{※1}の生産性を実現したスクラバー方式^{※2}の枚葉式ウエハー洗浄装置「SS-3200」を開発。次世代半導体の製造ニーズに対応するこの装置の販売を、2011年12月から開始します。



SS-3200

☆ この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、
下記URLよりダウンロードできます。
(www.screen.co.jp/press/nr-photo_2009-2011.html)

近年の半導体デバイスは、スマートフォンやタブレットPCをはじめとする、小型で高性能な電子端末などに搭載される極小の電子部品に対応するため、回路の線幅は10ナノメートル(1億分の1メートル)に迫るほどの超微細化が進み、同時に、回路を立体的に形成する多層化も進んでいます。そのため各デバイスメーカーでは、より優れた洗浄性能で歩留まりの向上が期待できるスクラバー方式のウエハー洗浄装置へのニーズがますます高まるとともに、製造工程の効率化にもつながる装置の高速化が求められています。

このような業界の動向に応えるため当社は、優れた洗浄能力と高い安定性に基づくプロセス性能を兼ね備え、世界最高の生産性を実現した枚葉式ウエハー洗浄装置「SS-3200」を開発しました。新開発のウエハー高速搬送機構を採用するとともに、制御プログラムを一新し、洗浄処理ユニット(チャンバー)の数を増やすことなく、従来の約2倍に相当する毎時800枚という実用処理能力を実現。また、当社の洗浄装置のベストセラーモデル「SS-3100」で高い評価を得ているプロセス性能や、8つのチャンバー構成によるコンパクト設計を継承しながら、半導体デバイスの超微細化や立体構造化にも対応しています。さらに「SS-3200」は、操作性やメンテナンス性に優れているほか、製造工程の複雑化や工程数の増大で課題となっているエネルギーの消費量削減にも貢献する、コストパフォーマンスの高い装置となっています。

当社は、今回の「SS-3200」の発売により、次世代洗浄装置のラインアップをさらに充実させ、高度化、多様化、省エネルギー化を求める顧客ニーズに幅広く対応していきます。そして、今後も半導体洗浄装置のリーディングカンパニーとして世界最高レベルの製品を提供し続け、業界の発展に貢献していきます。

※1 2011年11月現在、当社調べ。

※2 スクラバー方式

ウエハーを柔らかいブラシと純水で物理的に洗浄する方式。純水だけで洗浄できる工程などでの使用に適している。

* この装置は、12月7日(水)から9日(金)まで千葉「幕張メッセ」で開催される「SEMICON Japan 2011」でご紹介します。